

Dell EMC PowerEdge C6420

仕様詳細

メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

章 1: 仕様詳細	4
Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドの寸法.....	4
シャーシの重量.....	5
プロセッサの仕様.....	5
対応オペレーティングシステム.....	5
システムバッテリー.....	5
拡張バスの仕様.....	5
メモリーの仕様.....	6
ドライブおよびストレージの仕様.....	6
ビデオの仕様.....	7
環境仕様.....	7
動作時の標準温度の仕様.....	7
動作時の拡張温度の仕様.....	15
粒子状およびガス状汚染物質の仕様.....	18
最大振動の仕様.....	19
最大衝撃の仕様.....	19
最大高度の仕様.....	19
Fresh Air 動作.....	19

仕様詳細

本項では、お使いのシステムの仕様詳細と環境仕様の概要を示します。

トピック：

- Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドの寸法
- シャーシの重量
- プロセッサの仕様
- 対応オペレーティングシステム
- システムバッテリー
- 拡張バスの仕様
- メモリーの仕様
- ドライブおよびストレージの仕様
- ビデオの仕様
- 環境仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドの寸法

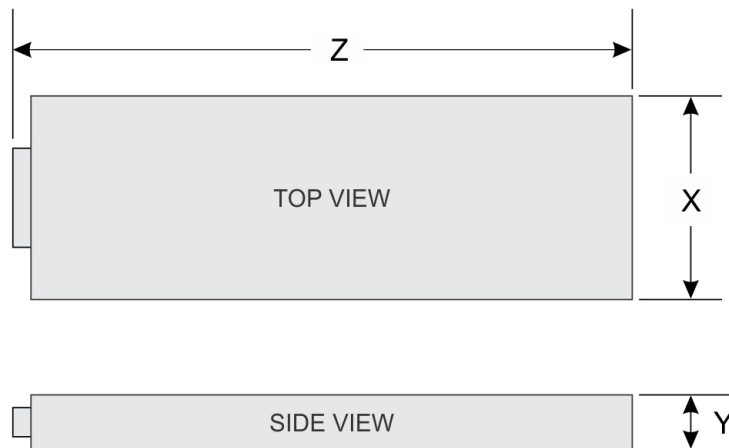


図 1. PowerEdge C6420 スレッドの寸法

表 1. PowerEdge C6420 スレッドの寸法

X	Y	Z
174.4 mm (6.86 インチ)	40.5 mm (1.59 インチ)	574.5 mm (22.61 インチ)

シャーシの重量

表 2. スレッドを含めたエンクロージャのシャーシ重量

システム	最大重量 (すべてのスレッドおよびドライブ)
12 x 3.5 インチ ハードドライブ システム	43.62 Kg (96.16 ポンド)
バックプレーン システムなし	34.56 Kg (76.19 ポンド)

プロセッサの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドは、それぞれ 4 基の独立したスレッド内に、最大 2 個のインテル Xeon Scalable プロセッサをサポートしています。各プロセッサでは、最大で 28 のコアがサポートされます。

① **メモ:** ファブリック プロセッサと非ファブリック プロセッサが混在した環境では、ファブリック プロセッサをプロセッサ 2 のソケットに取り付ける必要があります。

対応オペレーティングシステム

Dell EMC PowerEdge C6420 は、次のオペレーティングシステムをサポートしています。

- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Hyper-V 搭載 Microsoft Windows Server
- Canonical Ubuntu LTS
- VMware ESXi
- Citrix XenServer

① **メモ:** 特定のバージョンおよび追加の詳細については、<https://www.dell.com/support/home/drivers/supportedos/poweredge-c6420> を参照してください。

システムバッテリー

PowerEdge C6420 スレッドは、交換可能な CR 2032 3V コイン型リチウム電池を使用します。

① **メモ:** 各スレッドにシステムのバッテリーがあります。

拡張バスの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドは、Generation 3 に対応した PCIe スロットを 4 基サポートします。

表 3. 拡張バスの仕様

PCIe スロット	説明	フォームファクタ
x8 メザニン PCIe ライザー	スロット 1: プロセッサ 1 からの x8 PCIe Gen3	カスタム フォーム ファクター
x8+x8 OCP メザニン ライザー	スロット 2: プロセッサ 1 からの x8 PCIe Gen3	標準 Open Compute Project (OCP) フォーム ファクター
	スロット 3: プロセッサ 1 からの x8 PCIe Gen3	
X16 PCIe メイン ライザー	スロット 4: x16 PCIe Gen3 プロセッサ 1	標準ロープロファイル PCIe フォーム ファクター

表 3. 拡張バスの仕様 (続き)

PCIe スロット	説明	フォームファクタ
x16 埋め込み型 PCIe ライザー	スロット 5 : プロセッサ 2 からの x16 PCIe Gen3	カスタム フォーム ファクター ①メモ: M.2 SATA ライザーは、埋め込みライザーでサポートされています。

メモリーの仕様

表 4. メモリーの仕様

メモリ モジュール ソケット	DIMM の タイプ	DIMM のラ ンク	DIMM の容量	シングルプロセッサ		デュアルプロセッサ	
				最小 RAM	最大 RAM	最小 RAM	最大 RAM
288 ピン (16)	LRDIMM	クワッドラ ンク	64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1024 GB
		オクタラ ンク	128 GB	128 GB	1024 GB	256 GB	2048 GB
	RDIMM	シングルラ ンク	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
		デュアルラ ンク	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
			32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
			64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1024 GB

①メモ: 同じ AMD EPYC™プロセッサ ユニットで、x4 データ幅と 8Gb DRAM 密度を備えた 32 GB 容量の古い RDIMM メモリーと、x8 データ幅と 16Gb DRAM 密度を備えた 32GB 容量の新しい RDIMM メモリーを混在させることはできません。

ドライブおよびストレージの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 のスレッドは、SAS および SATA ドライブと SSD (ソリッドステートドライブ) をサポートしています。

表 5. PowerEdge C6420 スレッドでサポートされているドライブ オプション

エンクロージャ内の最大ドライブ数	スレッドごとに割り当てられる最大ドライブ数
12 x 3.5 インチ ドライブ システム	スレッドごとに 3 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD
24 x 2.5 インチ ドライブ システム	スレッドごとに 6 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD
24 x 2.5 インチ ドライブ システム、NVMe 搭載	NVMe バックプレーンは次の構成のいずれかをサポートします。 <ul style="list-style-type: none"> スレッドごとに 2 台の NVMe ドライブおよび 4 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD スレッドごとに 6 台の SAS または SATA ドライブおよび SSD
M.2 SATA ドライブ (オプション)	M.2 SATA カードでサポートされる容量は最大 240GB ①メモ: M.2 SATA カードは、x8 (スロット 1) メザニン ライザーまたは x16 ライザー スロット (スロット 5) に取り付けすることができます。
起動用 microSD カード (オプション) (最大 64 GB)	各スレッドの各 PCIe ライザーに 1 枚

表 6. M.2 SATA ドライブを使用した場合にサポートされる RAID オプション

オプション	1台の M.2 SATA ドライブ (RAID なし)	2台の M.2 SATA ドライブ(ハードウェア RAID あり)
ハードウェア RAID	無	有
RAID モード	該当なし	RAID 1
サポートされているドライブ数	1	2
サポートされているプロセッサ	プロセッサ 1	プロセッサ 1 およびプロセッサ 2

ビデオの仕様

Dell EMC PowerEdge C6420 スレッドは、16 MB RAM の Matrox G200 統合グラフィックス カードをサポートしています。

表 7. サポートされているビデオ解像度のオプション

解像度	リフレッシュレート (Hz)	色深度 (ビット)
1024 x 768	60	最大 24
1280 x 800	60	最大 24
1280 x 1024	60	最大 24
1360 x 768	60	最大 24
1440 x 900	60	最大 24

環境仕様

以下のセクションには、システムの環境仕様についての情報が含まれています。

① **メモ:** 環境認定の詳細については、www.dell.com/poweredgemanuals の [マニュアルおよび文書] にある『製品環境データシート』を参照してください。

動作時の標準温度の仕様

① **メモ:**

1. 使用不可：構成が Dell EMC で提供されていないことを示します。
2. 非対応：構成が温度の面でサポートされていないことを示します。

① **メモ:** 周囲温度が次の表に記載された継続動作時の最高温度以下である場合、DIMM、通信カード、M.2 SATA、PERC カードなどのすべてのコンポーネント (Mellanox DP LP カードおよびインテル Rush Creek カードを除く) は、十分な熱的余裕でサポートされます。

表 8. 動作時の標準温度の仕様

標準動作温度	仕様
温度範囲 (高度 950 m (3117 フィート) 未満)	10 ~ 35°C (50 ~ 95°F)、装置への直射日光なし。

① **メモ:** 一部の構成では、周囲温度をより低くする必要があります。詳細については、次の表を参照してください。

表 9. ファブリック非対応デュアルプロセッサ構成の継続動作時最高温度

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリプロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ					BP 以外のシャーシ	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
205 W	8280	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	非対応 (2°C)	非対応 (10°C)	非対応 (11°C)	非対応 (19°C)	20	21	21	21	21	30
	8280L	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8					20	21	21	21	21	30
	8280M	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8					20	21	21	21	21	30
	8270	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8					20	21	21	21	21	30
	8268	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8					20	21	21	21	21	30
200 W	6254	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	非対応 (6°C)	非対応 (14°C)	非対応 (15°C)	20	21	22	22	22	22	30
165 W	8276	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	非対応 (11°C)	非対応 (18°C)	非対応 (19°C)	30	30	30	30	30	35	35
	8276L	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35
	8276M	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35
	8260	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35
	8260L	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35
	8260M	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35

表 9. ファブリック非対応デュアルプロセッサ構成の継続動作時最高温度 (続き)

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリプロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ					BP 以外のシャーシ	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
	8260C	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8				30	30	30	30	30	35	35
150 W	6252	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	非対応 (14°C)	21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6248	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6242	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6244	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6240C	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
125 W	6230	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5220	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	8253	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35

表 9. ファブリック非対応デュアルプロセッサ構成の継続動作時最高温度 (続き)

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリプロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
	6238T	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
115 W	5217	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
105 W	5218T	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1 : FMM2M CPU2 : V2DRD	CPU1 : 6 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	5215	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 9. ファブリック非対応デュアルプロセッサ構成の継続動作時最高温度（続き）

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし	
	4214	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70 W	4209T	CPU1 : JYKMM CPU2 : V2DRD	CPU1 : 8 CPU2 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 10. 非ファブリック シングルプロセッサ構成の場合の継続動作時最高温度

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシンクモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ	
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし	
205 W	8280	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8280L	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8280M	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8270	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
	8268	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
200 W	6254	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35
165 W	6212U	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 10. 非ファブリック シングル プロセッサ 構成の場合の継続動作時最高温度 (続き)

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシंकモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
	8276L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8276M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8260C	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
150 W	6210U	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6252	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6248	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6242	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6244	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240C	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125W	6230	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218B	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8253	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6238T	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6230N	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
115 W	5217	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 10. 非ファブリック シングル プロセッサ構成の場合の継続動作時最高温度 (続き)

TDP ワット数	プロセッサのモデル	ヒートシミュレーションモデル	最大メモリ/プロセッサ	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						BP 以外のシャーシ
				12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	24x ドライブ	20x ドライブ	16x ドライブ	12x ドライブ	8x ドライブ	4x ドライブ	該当なし
105 W	5218T	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5218N	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5222	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	8256	CPU1 : FMM2M	CPU1 : 6	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100 W	4216	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85 W	5215	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215M	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5215L	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4215	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4214C	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4208	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	3204	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
70 W	4209T	CPU1 : JYKMM	CPU1 : 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 11. Active (Optical) で接続した Mellanox Navi デュアル ポート カードの構成に関する制限事項

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
205 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	23
200 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	23
173 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	24	24	28
165 W	非対応	非対応	非対応	24	25	25	26	29
160 W	非対応	非対応	非対応	24	25	26	26	30
150 W	非対応	非対応	非対応	26	27	28	28	31
140 W	非対応	23	25	28	29	29	30	33

表 11. Active (Optical) で接続した Mellanox Navi デュアル ポート カードの構成に関する制限事項 (続き)

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
135 W	非対応	24	25	29	30	30	31	33
130 W	非対応	24	26	30	31	31	31	34
125 W	20	25	27	30	31	32	32	35
115 W	21	27	28	32	33	34	34	>35
113 W	21	27	28	32	33	34	34	>35
105 W	22	28	30	34	35	>35	>35	>35
85 W	23	32	33	>35	>35	>35	>35	>35
70 W	25	34	>35	>35	>35	>35	>35	>35

表 12. インテル Rush Creek の構成に関する制限事項

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
205 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	20	20	23
200 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	21	21	24
173 W	非対応	非対応	非対応	20	20	23	24	28
165 W	非対応	非対応	非対応	22	22	24	25	29
160 W	非対応	非対応	非対応	22	22	24	26	29
150 W	非対応	非対応	非対応	24	24	26	27	30
140 W	非対応	非対応	非対応	26	26	27	28	31
135 W	非対応	非対応	20	26	26	28	29	32
130 W	非対応	非対応	20	27	27	29	29	33
125 W	非対応	非対応	21	28	28	30	30	33
115W	非対応	21	23	29	31	31	32	34
105 W	20	23	24	30	33	33	34	>35
85 W	24	26	27	34	>35	>35	>35	>35
70 W	25	28	29	>35	>35	>35	>35	>35

表 13. インテル NVMe SSD AIC P4800X の構成に関する制限事項

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
205 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
200 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
173 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	20
165 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	20
160 W	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	25
150 W	非対応	非対応	非対応	非対応	20	20	20	25

表 13. インテル NVMe SSD AIC P4800X の構成に関する制限事項 (続き)

TDP ワット数	3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ				BP 以外のシャーシ
	12 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	24 x HDD	16 x HDD	8 x HDD	4 x HDD	該当なし
140 W	非対応	非対応	非対応	20	20	20	20	25
135 W	非対応	非対応	非対応	20	20	20	20	25
130 W	非対応	非対応	非対応	20	20	20	20	25
125 W	非対応	非対応	非対応	20	25	25	25	30
115 W	非対応	非対応	非対応	25	25	25	25	30
105 W	非対応	非対応	非対応	25	25	25	25	30
85 W	非対応	非対応	非対応	30	30	30	30	>35
70 W	非対応	非対応	非対応	>35	>35	>35	>35	>35

動作時の拡張温度の仕様

表 14. 動作時の拡張温度

動作時の拡張温度	仕様
継続動作	<p>相対湿度 5% ~ 85%、最大露点温度 29°C で、5°C ~ 40°C。 ⓘ メモ: 標準動作温度 (10°C ~ 35°C) の範囲外では、下は 5°C まで、上は 40°C までで、システムは継続的に動作できません。</p> <p>35°C ~ 40°C の場合、950 m を超える場所では 175 m (319 フィート) 上昇するごとに最大許容温度を 1°C (1°F) 下げます。</p>
年間動作時間の 1 パーセント以下	<p>相対湿度 5% ~ 90%、最大露点温度 29°C で、-5°C ~ 45°C。 ⓘ メモ: 標準動作温度範囲 (10°C ~ 35°C) 外で使用する場合は、最大年間動作時間の最大 1% まで -5°C ~ 45°C の範囲で動作することができます。</p> <p>40°C ~ 45°C の場合、950 m を超える場所では 125 m (228 フィート) 上昇するごとに最大許容温度を 1°C (1°F) 下げます。</p>

ⓘ **メモ:** 動作時の拡張温度範囲で使用すると、システムのパフォーマンスに影響が生じる場合があります。

ⓘ **メモ:** 拡張温度範囲でシステムを使用している際に、システムイベントログに周囲温度の警告が報告される場合があります。

動作時温度ディレーティングの仕様

表 15. 動作温度

動作時温度ディレーティング	仕様
≤ 35°C (95°F)	950 メートル (3,117 フィート) を超える高度では、最高温度は 300 メートル (547 フィート) ごとに 1°C (1°F) 低くなります。
35°C ~ 40°C (95°F ~ 104°F)	950 メートル (3,117 フィート) を越える高度では、最高温度は 175 メートル (319 フィート) ごとに 1°C (1°F) 低くなります。
≥ 45°C (113°F)	950 メートル (3,117 フィート) を越える高度では、最高温度は 125 メートル (228 フィート) ごとに 1°C (1°F) 低くなります。

相対湿度の仕様

表 16. 相対湿度の仕様

相対湿度	仕様
ストレージ	最大露点 33 °C (91 °F) で 5 ~ 95 % の相対湿度。空気は常に非結露状態であること。
動作時	最大露点 29 °C (84.2 °F) で 10% ~ 80% の相対湿度。

温度の仕様

表 17. 温度の仕様

温度	仕様
ストレージ	-40 °C ~ 65 °C (-40 °F ~ 149 °F)
継続動作 (高度 950 m (3117 フィート) 未満)	10 °C ~ 35 °C (50 °F ~ 95 °F)、装置への直射日光なし。
Fresh Air	外気に関する詳細については、拡張動作温度の項を参照してください。
最大温度勾配 (動作時および保管時)	20 °C/h (68 °F/h)

① | **メモ:** 一部の構成では、より低温の周囲温度が必要です。詳細については、「[動作時の標準温度の仕様](#)」を確認してください。

温度制限

表 18. デュアルプロセッサ用の熱制限マトリックス

最大継続動作時の吸気口温度 (° C)													
				3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ					非 BP シャーシ	
TDP (ワット)	Proc No.	DPN CPU ヒートシンク	最大 DIMM スロット数	12 x Hdd	HDD	HDD	24x Hdd	20 倍 Hdd	ddr4 Hdd	12 x Hdd	HDD	HDD	該当なし
165W	6238R	CPU1{ A7、CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8	非対応			30	30	30	30	30	35	35
	6240R	CPU1{ A7、CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8	非対応	非対応		30	30	30	30	30	35	35
150W	6230R	CPU1{ A7、CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35
	6226R	CPU1{ A7、	CPU1: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35

表 18. デュアルプロセッサ用の熱制限マトリックス (続き)

最大継続動作時の吸気口温度 (°C)														
		CPU2 }	CPU2: 8											
	6208 U	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35	
150W	5220 R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8		21	23	30	30	30	30	30	35	35	
130W	4215R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8		25	25	30	30	35	35	35	35	35	
125W	5218R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35	
100W	4214R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	4210R	CPU1: 8 CPU2: 8	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
95W	42 10T	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	3206R	CPU1{ A7、 CPU2 }	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 19. シングルプロセッサ用の熱制限マトリックス

最大継続動作時の吸気口温度 (°C)														
				3.5 インチ シャーシ			2.5 インチ シャーシ						非 BP シャーシ	
TDR (ワット)	Proc No.	DPN CPU ヒートシンク	最大 DIMM スロット数	12 x Hdd	HDD	HDD	24x Hdd	20 倍 Hdd	ddr4 Hdd	12 x Hdd	HDD	HDD	HDD	該当なし
165W	6238R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6240R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

表 19. シングルプロセッサ用の熱制限マトリックス (続き)

最大継続動作時の吸気口温度 (°C)													
150W	6230R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6226R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	6208U	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	5220R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35
130W	4215R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
125W	5218R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
100W	4214R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	4210R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
95W	42 10T	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
85W	3206R	CPU1{ CPU2}	CPU1: 8 CPU2: 8	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

粒子状およびガス状汚染物質の仕様

表 20. 粒子状汚染物質の仕様

粒子汚染	仕様
空気清浄	データ センターの空気清浄レベルは、ISO 14644-1 の ISO クラス 8 の定義に準じて、95% 上限信頼限界です。
<p>① メモ: この条件はデータ センターの環境にのみ適用されます。空気清浄要件は、事務所や工場現場などのデータ センター外での使用のために設計された IT 装置には適用されません。</p>	
<p>① メモ: データ センターに吸入される空気は、MERV11 または MERV13 フィルタで濾過する必要があります。</p>	
伝導性ダスト	空気中に伝導性ダスト、亜鉛ウイスカ、またはその他伝導性粒子が存在しないようにする必要があります。
<p>① メモ: この条件は、データ センター環境と非データ センター環境に適用されます。</p>	
腐食性ダスト	空気中に腐食性ダストが存在しないようにする必要があります。

表 20. 粒子状汚染物質の仕様（続き）

粒子汚染	仕様
空気中の残留ダストは、潮解点が相対湿度 60% 未満である必要があります。	
① メモ: この条件は、データセンター環境と非データセンター環境に適用されます。	

表 21. ガス状汚染物質の仕様

ガス状汚染物	仕様
銅クーボン腐食度	クラス G1 (ANSI/ISA71.04-2013 の定義による) に準じ、ひと月あたり 300 Å 未満。
銀クーボン腐食度	クラス G1 (ANSI/ISA71.04-2013 の定義による) に準じ、ひと月あたり 200 Å 未満。
① メモ: 50% 以下の相対湿度で測定された最大腐食汚染レベル	

最大振動の仕様

表 22. 最大振動の仕様

最大耐久震度	仕様
動作時	0.26 Grms (5 ~ 350 Hz) (全稼働方向)。
ストレージ	1.88 Grms (10 ~ 500 Hz) で 15 分間 (全 6 面で検証済)。

最大衝撃の仕様

表 23. 最大衝撃の仕様

最大耐久衝撃	仕様
動作時	X、y、z 軸の正および負方向に 6 G の衝撃パルスを 24 回、11 ミリ秒以下 (システムの各面に対して 4 パルス)。
ストレージ	X、y、z 軸の正および負方向に 2 ミリ秒以下で 71 G の 6 連続衝撃パルス (システムの各面に対して 1 パルス)。

最大高度の仕様

表 24. 最大高度の仕様

最大高度	仕様
動作時	3048 m (10,000 ft)
ストレージ	12,000 m (39,370 フィート)

Fresh Air 動作

Fresh Air 動作の制限

- TDP が 105 W を超えるプロセッサはサポートされない
- PERC 制限のない 85 W 以下のプロセッサのサポート

- 3.5 インチ ドライブ構成はサポートされない
- CPU1ソケットのプロセッサに 114 mm のヒートシンクが必要
- Kerby-flat OCP はサポートされない
- DCS メザニン スロット上の M.2 カードはサポートされない
- NVMe SSD はサポートされない
- AEP DIMM および LRDIMM はサポートされない
- 25 W を超える PCIe カードはサポートされない
- 105 W のプロセッサの H730 PERC および H330 のサポート
- 85 W 以下の TDP プロセッサには PERC 制限なし